

证券代码：688807

证券简称：优迅股份

厦门优迅芯片股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	华安基金、银河基金、敦和资管、民生加银基金、诺德基金、湖南源乘投资、先锋基金、望正资产、博普资产、国投瑞银基金、华西基金、运舟资本、中信资管、新思哲、拾贝投资、坤溪投资、恒泽投资、中信自营、国源信达资本、中信证券、中邮证券、东方财富证券、财通证券、华福证券、招商证券、德邦基金等
时间	2026年1月9日下午2点-3点半
地点	厦门市软件园观日路54号之二三楼公司会议室
上市公司接待人员	董事、总经理：柯腾隆 副总经理：林智、陈哲 董事会秘书兼财务总监：杨霞 投资总监：廖丽玲 证券事务代表：黄婉香
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：请简要介绍公司情况？ 公司成立于2003年2月，总部位于厦门，是中国首批专业从事光通信前端高速收发芯片的设计公司，参与制定了国家及行业标准数十项，拥有国内外自主知识产权百余项，是国家知识产权优势企业，国家规划布局内集成电路设计企业，国家专精特新“小巨人”企业，国家制造业单项冠军，是国内光通信芯片行业领军企业。

优迅股份致力于深耕无线接入、云计算、光接入网、数据中心、AI 计算和骨干网等领域，为全球光模块厂商和系统设备商提供速率涵盖 155Mbps~800Gbps 高速收发芯片解决方案，拥有从芯片级、器件级、模块级、终端级、系统级完整的测试验证开发平台。多年来经过核心技术团队持续研发和攻关，在相关技术领域已达到国际先进、国内领先水平。完成国家多项科研项目，与国内外知名运营商、系统设备商、模块商建立了战略合作伙伴关系。与全球多家著名半导体晶圆制造厂、封装测试厂建立了长期稳定的合作关系。

第二部分：Q&A

1、公司 2025 年的营收情况预计如何？2026 年预计营收情况如何？

A：公司 2025 年全年营收预计为 4.75 亿至 4.95 亿元，2026 年营收规模预计将继续保持增长态势。

2、在数据中心侧，对应的高速率数据中心电芯片主要客户是哪些？公司数据中心侧高速率电芯片产品的进展如何？

A：在数据中心侧，公司的高速率电芯片主要面向国内主流光模块制造商及互联网头部企业。针对数据中心侧高速率电芯片产品，优迅股份的单波 100G TIA+Driver 芯片已取得关键进展，该芯片主要面向 400G/800G FRO 光模块应用，目前已进入客户送样测试阶段，正配合目标客户进行全面的性能摸底与功能验证。

3、优迅股份的电芯片产品目前主要的客户是哪些？以及未来客户拓展规划？

A：优迅股份电芯片产品的核心客户覆盖全球主流运营商、通信系统设备商及头部光模块厂商。面向未来，公司计划在巩固现有市场的同时，积极拓展海外互联网科技巨头与大型汽车企业等新兴客户领域。

4、硅光模式下，对公司电芯片产品的需求量的变化趋势如何？

A: 在硅光技术模式下，对于带 DSP 芯片的硅光模块，存在 DSP 集成 Driver 的可能性，但对集成 TIA 的实测效果目前尚不理想。因此，公司仍可为客户提供配套的独立 TIA 产品。对于 LPO 硅光模块，则同时需要 Driver 和 TIA。

5: 在 LPO 技术演进下，公司的电芯片价值量将会如何变化？

A: 在 LPO 技术演进下，由于移除了 DSP，公司 TIA+Driver 芯片的绝对价值量及其在系统中的相对价值占比均将得到提升。

6、目前公司的产品结构有优势吗？

A: 公司已构建了坚实的技术护城河，产品线覆盖全面，并长期为行业头部客户提供稳定的大批量供货，积累了深厚的客户合作关系与市场信任，形成了显著的产品与市场综合优势。同时，公司是中国通信标准化协会的全权会员，与国内主流的通信运营商、设备商、模块商等产业链上下游合作伙伴联合制修订光通信相关行业标准二十余项，涵盖 GPON/XGSPON/50GPON 接入网、25G 无线接入 xWDM 系列、4X100G/8X100G 等数通领域，保持对行业发展趋势的跟踪、引领作用，协同支持公司业务发展。

7、公司目前的供应链情况如何？会出现供应链紧张的情况吗？国内有没有替代厂商？

A: 公司产品目前主要采用 CMOS 与锗硅 (SiGe) Bi-CMOS 两种工艺平台。其中，CMOS 工艺因其技术成熟、产能稳定，在公司产品中占主导地位，其供应链目前处于正常状态；国内 CMOS 晶圆的制造技术已相当成熟，供应链安全有保障。在锗硅 Bi-CMOS 工艺方面，其全球晶圆产能确实存在结构性紧张的情况，但对公司整体运营与产品交付未构成实质性影响。目前，公司正在就锗硅工艺在国内寻求替代晶圆供应商。

	<p>8、公司在电信侧领域面临的市场竞争情况如何？</p> <p>A：在电信侧领域，公司的产品已经历了充分的市场竞争，当前已确立并保持了显著的竞争优势与领先市场地位。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照《投资者关系管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
风险提示	<p>以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
日期	2026年01月09日